

特 点

- 简单的混合比例 1: 1。
- 可操作时间长。
- 防潮性及耐化学性佳。
- 耐热冲击性优异。

基 本 物 性

		<u>主剂(B 剂)</u>	<u>硬化剂(A 剂)</u>
黏 度 :	@25°C	100,000 – 200,000 cps	10,000 – 25,000 cps
比 重 :	@25°C	1.49 – 1.54	1.35 - 1.39
闪 火 点 :	ASTM D93	>94° C	>94° C
混 合 比 :	重量比	100	: 100

混 合 后 物 性

混 合 后 黏 度 :	@25°C	20,000 – 50,000 cps
	@75°C	4,000 – 9,000 cps
可 操 作 时 间 :	@25°C	2 – 3 天
胶 化 时 间 :	@135°C	10 – 15 分钟
硬 度 :		Shore D 80
工 作 温 度 :		-55°C – 180°C
抗 拉 强 度 :	ASTM D638	2,900 psi
延 伸 率 :	ASTM D638	13 %
冷 热 环 境 试 验 :	5 循环	-55°C – 150°C 通过
玻 璃 转 化 温 度 (Tg) :	ASTM E831	22°C
热 传 导 系 数 :	ASTM C518	0.4 W/mK
热 膨 胀 系 数 :	Tg 前	95 ppm/°C
	Tg 后	345 ppm/°C
保 存 期 限 :	@25°C	6 个月(未开封)

电 气 特 性

绝 缘 强 度 :	100mils	450 Vpm (18 kV/mm)
	100mils、浸水 24 小时	450 Vpm (18 kV/mm)
表 面 阻 抗 :	@25°C	2.2×10^{16} ohms/sq
体 积 电 阻 :	@25°C	1.1×10^{15} ohm-cm
绝 缘 常 数 :	@25°C、1KHz	3.5
	@100°C、1KHz	4.9
	@150°C、1KHz	4.9
	@200°C、1KHz	4.6
消 散 因 素 :	@25°C、1KHz	0.01
	@100°C、1KHz	0.02
	@150°C、1KHz	0.06
	@200°C、1KHz	0.17

作 业 流 程

1. 组件预温 120-150°C。
2. 树脂与硬化剂经过一段时间存放会沉淀，所以在称量前需将树脂与硬化剂分别搅拌均匀再称量、混合如此比例才会正确。(将树脂加热到 70-75°C，较易搅拌均匀)。
3. 若有需要可将树脂预温 50-60°C 左右降低黏度，以利搅拌，抽真空与灌注作业。
4. 将混合后的树脂抽真空脱气泡。
5. 将预温好的组件放入真空槽中并抽真空。
6. 将脱好泡的树脂经由导管灌入真空中温热的组件。
7. 灌胶完成后，真空仍再维持 30 分左右。
8. 缓慢破真空，并维持常温常压 1 小时。
9. 加温 135°C x 4-6 小时。
10. 趁模仍温热时将组件脱模。
11. 若需耐高温或达最佳性能，请以 80°C 加温 4 小时后，再以 120°C 加温 4 小时，最后再以 150°C 加温 4 小时。